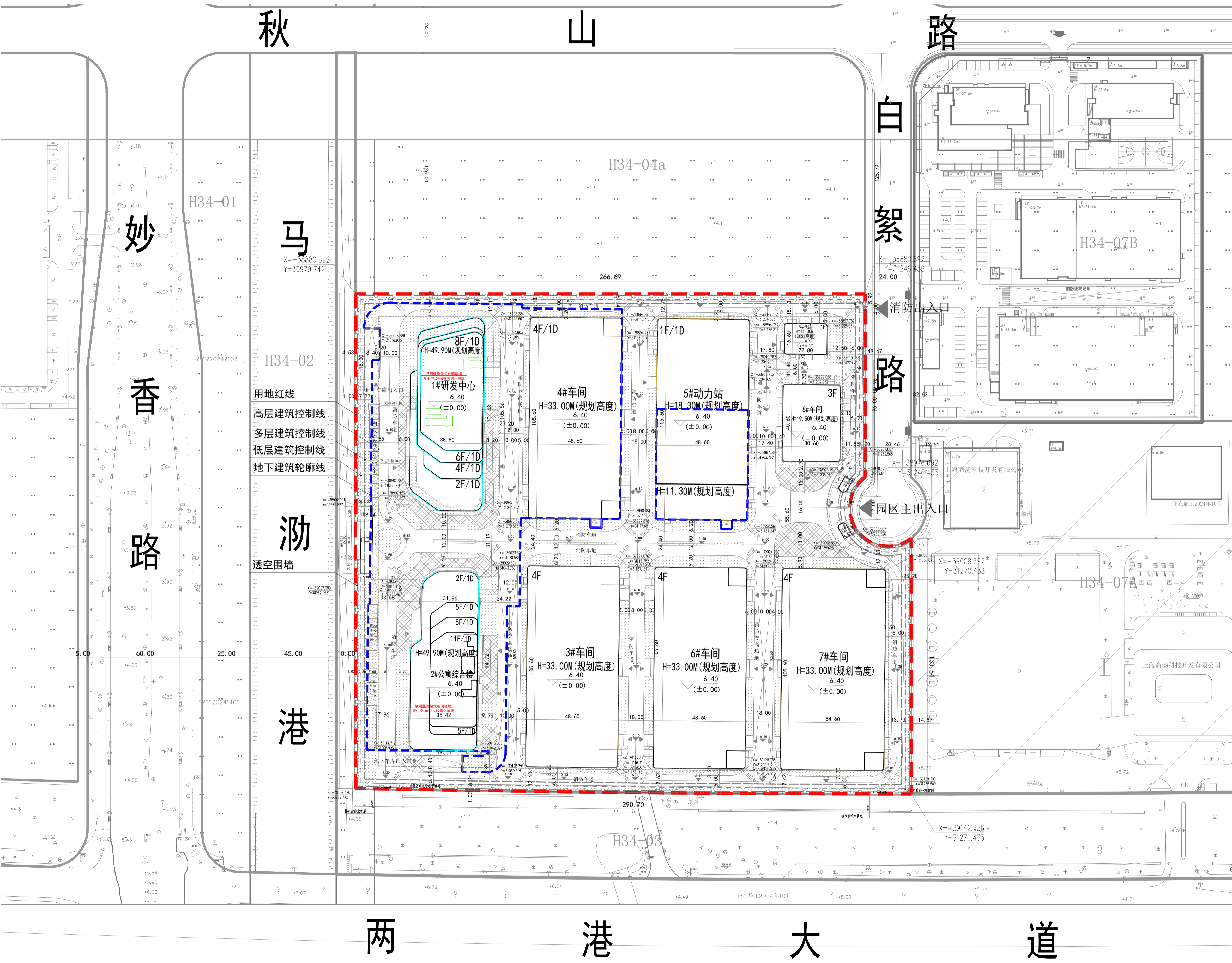


# 规划设计方案公示(含玻璃幕墙)



项目名称: 半导体核心零部件及系统项目  
 项目建设单位: 上海元创科芯半导体有限公司  
 项目建设地点: 东至白絮路、H34-07a地块, 西至马泐港东侧生产防护绿地, 南至H34-03地块, 北至H34-04a地块  
 规划用地性质: 一类工业用地  
 用地面积: 72432.68平方米  
 建筑工程性质: 工业建筑

经济技术指标表		
名称	数量	单位
规划用地面积	72432.68	m <sup>2</sup>
总建筑面积	159577.95	m <sup>2</sup>
地上建筑面积	132985.41	m <sup>2</sup>
地下建筑面积	26592.54	m <sup>2</sup>
总计容建筑面积	178334.39	m <sup>2</sup>
容积率	2.46	
建筑密度	0.47	
绿地率	20.17%	%
机动车停车数量	550	个
非机动车停车数量	0	个

图例:

用地/道路红线 ————

地下建筑范围 ————

玻璃幕墙范围 ————

地面绿化

机动车位

方案公示起止时间: 2026年 月 日至 月 日

收集意见截止日期: 2026年 月 日

方案公示意见收集方式:

1. 上海元创科芯半导体有限公司  
 地址: 上海市浦东新区南汇新城方竹路566弄18号

联系电话: 18634698962

联系人: 尉静

2. 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会

地址: 申港大道200号

E-MALL: lgzmqgzc@163.com

请在信函封面或邮件名称上注明“项目方案公示意见”。也可到项目所在地相关镇、街道、居(村)委会反映。